

# 低アウトガス性・次世代型サーマルグリース/ギャップフィラー

PU  
PASTE

## 電子部材向けウレタン系放熱ペースト

ひつついで、熱を逃がしてやまない。

### こんなお客様に

- ✓ モビリティ部品の発熱による性能低下にお悩み
- ✓ 密着不良による排熱性能低下にお悩み
- ✓ 低分子シロキサンフリー化を図りたい 等

### ペースト提供形態



## YG/YGFシリーズ特徴

### 01 | 製品ラインナップ

TYPE C1	低コストグレード	1.8 W/m·K
TYPE C2	低熱伝導グレード	2.5 W/m·K
TYPE O	中熱伝導グレード	3.2 W/m·K
TYPE M	高熱伝導グレード	4.6 W/m·K

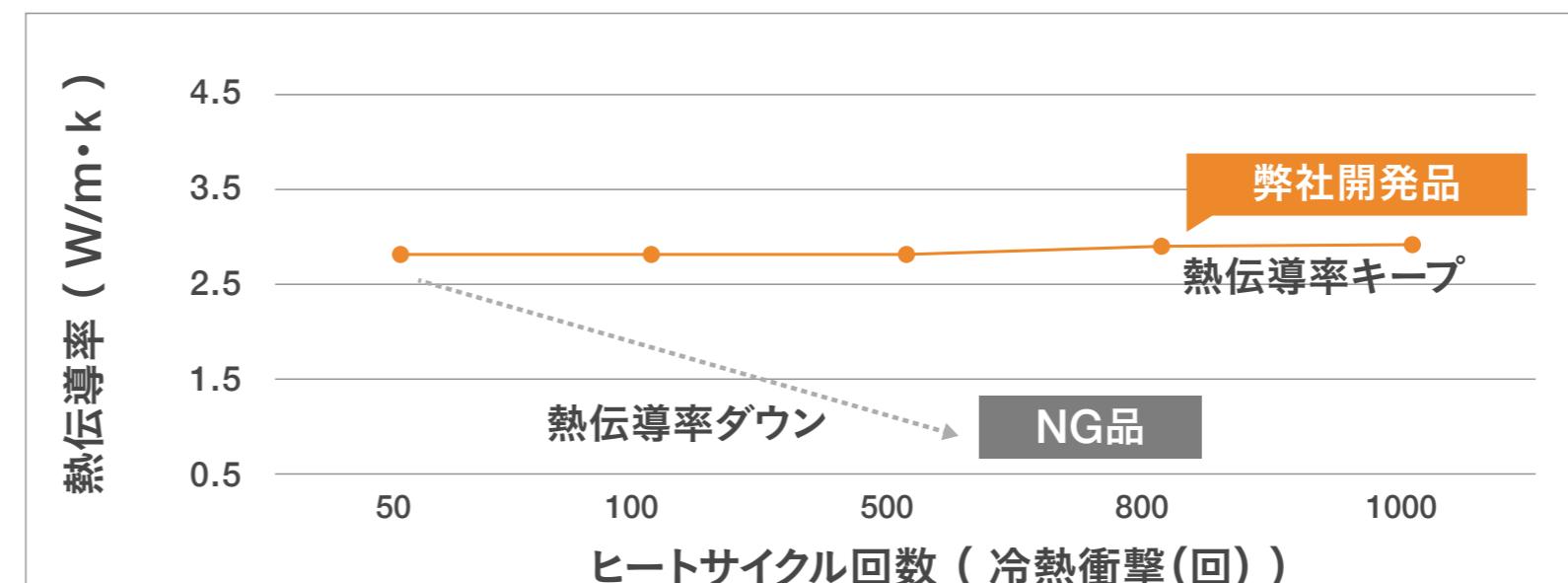
\* 測定方法 | ホットディスク法

### 03 | 保管安定性



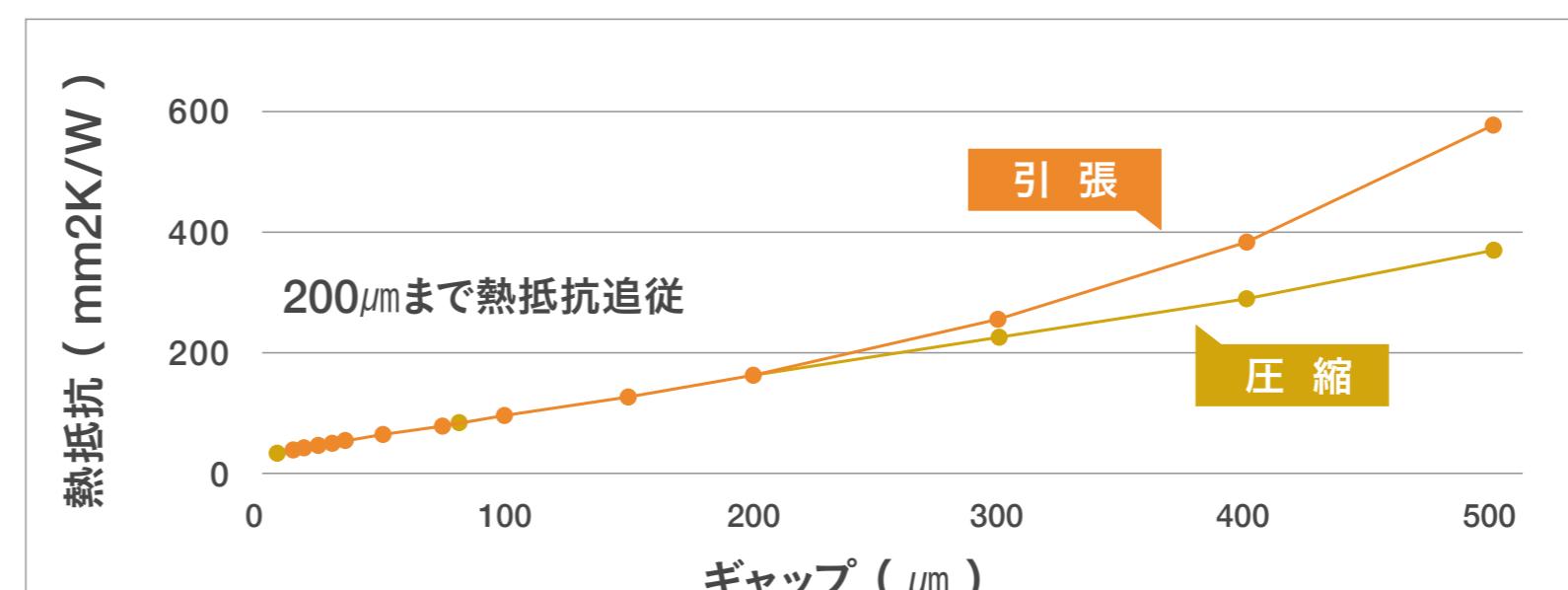
\* 保管条件 | 室温30日静置

### 02 | ヒートサイクル試験



\* 1サイクル | 降温→▲40°C/30min→昇温→150°C/30min  
温度条件 | ▲40~150°C

### 04 | 追従性



\* 測定方法 | TIMA5

本資料における各種物性データは、特定条件下における弊社評価結果ですので保証値ではありません。成形方法や成形条件、お取り扱い樹脂の特性により、測定結果が変わる可能性もあります。

**大日精化工業株式会社** / Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

ファインポリマー事業部 開発課 TEL:03-3665-5645 E-mail:fp\_daicolor.co.jp-bounces@daicolor.co.jp